パルスエキシマレーザー照射による β-Ga₂O₃ 薄膜の 室温固相エピタキシーにおける結晶化過程の評価

Investigation on solid-phase epitaxy process of β-Ga₂O₃

by pulsed excimer laser annealing at room temperature

東工大物質理工¹、 (株)豊島製作所²、神奈川県産技総研³

^O(M1)森田 公之¹, (M1)大賀 友瑛¹, 土嶺 信男², 金子 智^{3,1}, 松田 晃史¹, 吉本 護¹

Tokyo Tech. Materials¹, TOSHIMA Manu.², KISTEC³

^OH. Morita¹, T. Oga¹, N. Tsuchimine², S. Kaneko^{3,1}, A. Matsuda¹, M. Yoshimoto¹

E-mail: morita.h.ad@m.titech.ac.jp

【はじめに】 β型酸化ガリウム (β-Ga₂O₃) は SiC や GaN より大きい約 4.9 eV のバンドギャップ を持つワイドギャップ半導体であり、その高結晶配向性の β-Ga₂O₃ 薄膜は紫外域のオプトエレク トロニクスをはじめ高耐圧パワーデバイスなどへの応用が期待されている^[1]。これまでエピタキ シャルβ-Ga₂O₃ 薄膜は MBE や CVD などの手法で 500°C 以上の高温成膜により作製されてきたが、 反応層生成や粗大な粒成長を抑制するため我々は NiO 緩衝層による成膜温度の低温化や、室温エ キシマレーザーアニーリング (ELA) による低温合成などについて報告してきた^[2,3]。短パルス幅 な紫外パルスレーザーを用いる ELA では、前駆体のバンドギャップに応じた波長を選択すること による半導体の効率的なエネルギー吸収と極短時間の結晶化を誘起することが可能となる一方で、 配向性制御やドーパントによる特性制御などデバイス構造形成のためには ELA プロセスによる β-Ga₂O₃ のエピタキシャル成長の観察や、照射パルス数など ELA 条件が結晶性・配向性、 表面モフォロジーに及ぼす影響について検討した。

【実験及び結果】 KrF エキシマレーザー(λ =248 nm、d=20 ns、1.5 J/cm²)を用いたパルスレーザ ー堆積法により希薄 O₂ 中(10⁻³ Pa)・室温(基板非加熱)で、NiO(111)緩衝層(t~5 nm)と非晶質

Ga₂O₃(t~30, 70 nm)を原子ステップ超平坦 α -Al₂O₃ (0001)基 板上に堆積した。続いて前駆体である amorphous-Ga₂O₃/NiO (111)/ α -Al₂O₃ (0001)積層膜に対して、光子エネルギー約 5 eV 相当の波長をもつ KrF エキシマレーザー(0.25 J/cm²)を大気 中・室温・非集光で基板側から 500—1500 パルス照射し、ELA を行った。ELA 後の薄膜は XRD 測定より(-201)配向している ことがわかった。図 1 に示した 500 パルス照射した薄膜(t~30 nm)の RHEED 像では 6 回対称性の streak パターンが観察さ れ、β-Ga₂O₃がエピタキシャル成長したことが分かった。図 2 に示した断面 TEM 像は t~70 nm の薄膜に 500 パルス照射し た結果であり、表面近傍の~30 nm に残留非晶質領域がみられ たことから、緩衝層界面から膜表面に向かってエピタキシャ ル成長したことが明らかとなった。当日は高分解能 TEM 像 や、膜の表面モフォロジーについても報告する。

M. Higashiwaki et al., Appl. Phys. Lett. **100**, (2012) 013504.
D. Shiojiri, et al, Crystal Growth **424** (2015) 38.
内田啓貴他、第 63 回応用物理学会春季学術講演会(2016).



Fig.1 RHEED patterns of a β -Ga₂O₃ thin film (~30 nm) formed by ELA on NiO (111)-buffered α -Al₂O₃ (0001) substrate by ELA.



Fig.2 Cross-sectional TEM image of β -Ga₂O₃ (~70 nm) / NiO (111) / α -Al₂O₃ (0001) layered structure formed by atmospheric ELA.